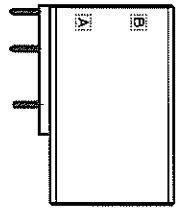
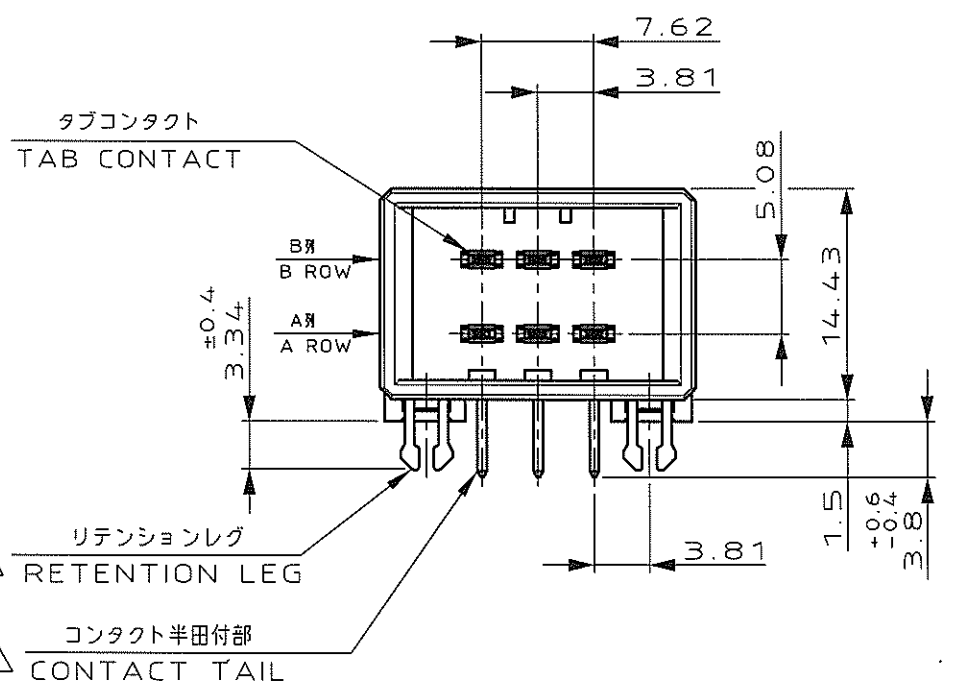
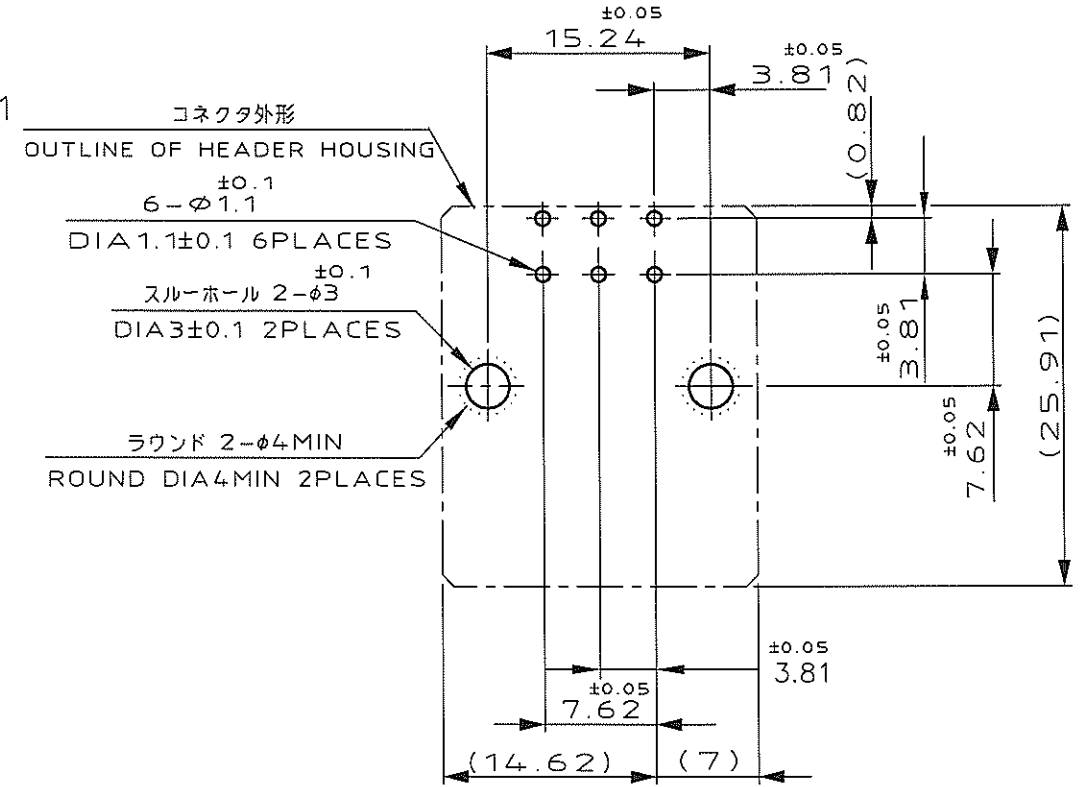
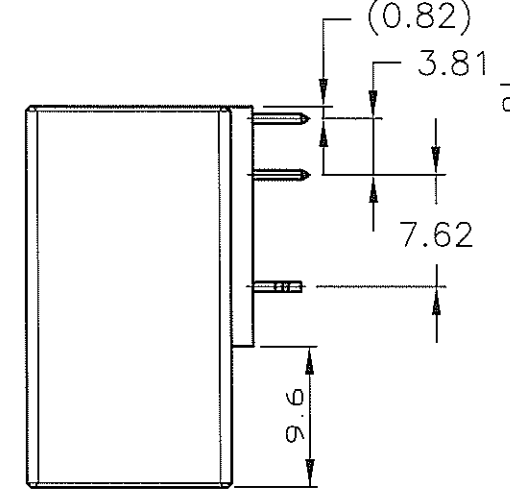
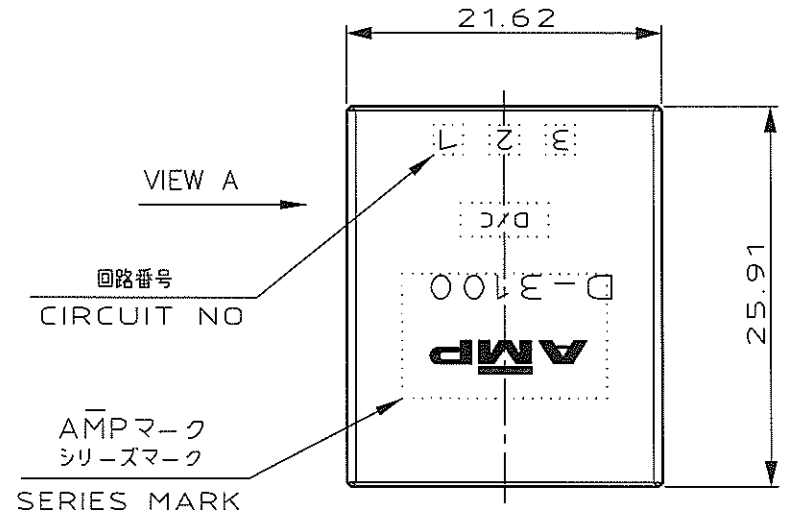


NUMBER 178303
METRIC

PRINT DIST DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT



VIEW A (SCALE:1:1)

△6	△4	178303-5
△6	△3	178303-3
△6	△2	178303-2
(FINISH)	製品番号 (PART NO.)	

推奨基板取付け穴寸法
PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- △2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- △3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- △4. FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- △5. FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- △6. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- △2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
- △3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
- △4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- △5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の上に半田めっき
- △6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部 : ニッケル下地の上にスズめっき

Copyright © 1991 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				Tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan					
C1	REVISED	ECR-07-013273	TS	DM	11/01/2007	WIRE RANGE	INSULATION DIA	NAME	ダイナミック D3100 水平タイプ 6 極 ヘッダーアセンブリ
C	REVISED	(FJDO-0039-03)	TS	S.M	6/2 '03	mm(AWG -)	mmφ	ダイナミック D3100 水平タイプ 6 極 ヘッダーアセンブリ	
B	REVISED	(FJDO-0097-03)	TS	S.M	4/15 '03	MATERIAL	FINISH	ダイナミック D3100 水平タイプ 6 極 ヘッダーアセンブリ	
A	REVISED	(FJ00-2183-95)	KI	SM	3-23 '95	SEE NOTE	SEE NOTE	ダイナミック D3100 水平タイプ 6 極 ヘッダーアセンブリ	
O	RELEASED	(J-1184)	NM	S.M	3-4 '92	注記参照	注記参照	ダイナミック D3100 水平タイプ 6 極 ヘッダーアセンブリ	
LTR	REVISION RECORD		DR	CHK	DATE	DR. N. Matsubara 14 JUN 91	DE. N. Matsubara 14 JUN 91	ダイナミック D3100 水平タイプ 6 極 ヘッダーアセンブリ	
						CHK. 71.0000 24/FEB/92	APP. S. MANABE 4/MAR/92	ダイナミック D3100 水平タイプ 6 極 ヘッダーアセンブリ	